

改良型聚四氟乙烯玻纤布陶瓷填充基板 F4BTMS-2

本产品是采用超薄玻纤布、纳米级陶瓷粉填料和聚四氟乙烯树脂经科学配制和严格工艺压制而成。在原有的聚四氟乙烯玻纤布基板的基础上，对材料配方和制作工艺进行了改良，其玻纤布的含量非常小，能替代国外同类型产品。

产品参数：

外 观	符合微波印制电路板材料国军标规定指标							
型 号	F4BTMS-2							
介电常数	2.2±0.03		2.65±0.04		2.94±0.04		3.0±0.04	
外型尺寸 (mm)	305×460		460×610		500×600		460×1220	
	特殊尺寸可根据客户要求压制							
厚度尺寸 及公差 (mm)	介质厚度	0.127	0.254	0.508	0.762	1.016	1.524	2.29
	公 差	±0.015	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05	±0.05	±0.08
	其他厚度请与我司联系							
铜箔规格	可选铜箔厚度： 0.50Z, 10Z							
	可选铜箔类型：普通电解铜箔、VLP 铜箔、HVLP 铜箔、50 Ω 电阻铜箔							
抗剥强度	1 0Z	>15N/cm						
热应力	浸锡，280℃×10s，≥3 次，不分层，不起泡。							
化学性能	根据基材特性可参照印制电路化学腐蚀法加工电路，而材料的介质性能不改变。							

博锐电路始终坚持“品质至上，服务根本”，的原则。为客户提供高效制造及可靠品质，迅速获得最佳的市场和竞争优势，是我们 永恒的目标。

如您需要工程技术支持或报价服务, 请联系工程技术：eq@brpcb.com ； 商务报价：sales@brpcb.com Web：www.brpcb.com

陈工 10 年 PCB 工程经验，专门为电子工程师提供 2-36 层（HDI 任意阶阻抗）叠层阻抗设计服务

Tel：19195667992 0755-23599845

物理 电 气 性 能	指标名称	测试条件		单位	指标数值		
	比 重	ER2. 2	常温	g/cm ³	2. 18		
		ER2. 65	常温	g/cm ³	2. 25		
		ER2. 94、3. 0	常温	g/cm ³	2. 3		
	吸水率	在 20±2℃蒸馏水中浸 24 小时		%	0. 02		
	使用温度	高低温箱		℃	-50~+260		
	热导系数			千卡/米小时℃	0. 6		
	热膨胀系数 (典型值)	-55 °~288℃ ER2. 2		ppm/°C	X	Y	Z
					15	16	35
		-55 °~288℃ ER2. 65		ppm/°C	X	Y	Z
					12	13	25
		-55 °~288℃ ER2. 94、3. 0		ppm/°C	X	Y	Z
					10	11	22
	收缩率	沸水中煮 2 小时		%	<0. 0002		
	表面绝缘电阻	500V 直流	常 态	M. Ω	≥1×10 ⁷		
恒定湿热			≥1×10 ⁶				
体积电阻	常 态		MΩ . cm	≥1×10 ⁸			
	恒定湿热			≥1×10 ⁷			
介电常数温度系数	-50 °~150℃		PPM/ °C	-20PPM			
介质损耗角正切值 ER2. 2/2. 65/2. 94/3. 0	10GH _z		tg δ	0. 0011			
阻燃性	94V-0						

产品特点:

1. 介电常数和介质损耗随温度变化系数小, 频率稳定性更好; 2. X/Y/Z 方向热膨胀系数降低;
3. 尺寸稳定性优良; 4. 表面平整; 5. 适合做高频多层压合; 6. 耐热性能和结合力优良。

产品应用:

航空航天器件, 军用雷达, 相控阵天线, 馈电网络天线, 卫星通信, 无源器件, 基站天线
博锐电路始终坚持“品质至上, 服务根本”, 的原则。为客户提供高效制造及可靠品质, 迅速获得最佳的市场和竞争优势, 是我们永恒的目标。

如您需要工程技术支持或报价服务, 请联系工程技术: eq@brpcb.com ; 商务报价:

sales@brpcb.com Web: www.brpcb.com

陈工 10 年 PCB 工程经验, 专门为电子工程师提供 2-36 层 (HDI 任意阶阻抗) 叠层阻抗设计服务 Tel: 19195667992 0755-23599845